



中國科學院為能物招加完施 Institute of High Energy Physics Chinese Academy of Sciences



## 高颗粒度时间探测器(HGTD) 外设读出电路的研发

葛振武1, 车铁旻1, 王传烨1, 翟明杰2, 梁志均1, 祁鸣1, 徐达2, 张杰2, 张雷1

1. 南京大学物理学院, 2. 中科院高能所

第二十一届全国核电子学与核探测技术学术年会,湖北恩施, 2023.08.09-11

□LHC计划在2025-2027年进行二期升级, 亮度增加十倍以上(HL-LHC)

●亮度的提升将使p-p对撞空间堆积事例分辨成为主要挑战

- □ 高颗粒度时间探测器(HGTD)是LHC二期升级中ATLAS的一个子探测器
  - ●位于桶部和端盖量能器之间,精确测量径迹时间信息(<30ps),测量亮度信息
  - ●朝前区辐照强(高达5.6×10<sup>15</sup> n/cm<sup>2</sup>)、安装空间小(z向125mm)、传输速率高(单通道达10.24Gbps)





PEB及柔性连接PCB



HGTD框图示意



## 背景: 外设电子学读出电路(Peripheral Electronics Board, PEB)

#### ● 功能:

- 编码、组合并传输前端模块测得的时间及亮度 信息(10.24Gbps)
- 向前端模块传输触发、时钟、参数配置信号 (2.56Gbps)
- 负责高低压直流电源分配管理,为前端模块提供高低压电源
- 监测HGTD探测器运行温度及电压
- 核心器件:
  - DC/DC(bPol12V)、收发芯片(lpGBT)、光电转换 芯片(VTRX+)、模拟64选1(MUX64)

#### PEB框图



● 由总计6种、160块PCB组成

● 报告主要内容: PEB设计原理验证、关键器件的验证、PEB研制的现状和计划

## PEB设计及验证:功能仿真机(模块化PEB)

- 全功能最小系统,关键元器件为单独子板
  - 可分别对其单独测试验证,减少设计风险
- 各子板可连接为全功能系统,开展系统级测试验证
  - 为PEB上下游系统的设计及测试提供必要支撑







## PEB设计及验证: 前端模块仿真器开发

- 项目前中期缺少前端模块时,代替模块帮助HGTD设计验证
- 基于Spartan 7 FPGA开发,模拟HGTD前端模块行为
  - 验证前端模块数字逻辑设计
  - 接收、处理trigger信号,通过I<sup>2</sup>C进行不同功能配置
  - 产生、编码并打包输出时间及亮度信息



#### 前端模块仿真器





#### 前端模块



## 核心器件的验证: bPol12V

- 为前端模块ASIC、IpGBT、mux64、VTRX+供电
- 优化bPol12V模块设计,提升效率、抑制纹波
  - 效率: ~76%, 随温度降低升高
  - 纹波:小于10 mV
  - 磁场测试: 效率及纹波不随磁场强度变化







## 核心器件的验证: lpGBT及VTRX+

- 1个lpGBT 可连接14个前端模块
  - 从前端模块接收测量数据并以10.24Gbps发送至VTRX
  - 向前端模块发送快/慢控制信号,提供时钟
  - 接收状态监测的模拟信号,并在内部ADC进行转换
- VTRX+将控制信号/测量数据进行光电转换





#### 核心器件的验证: MUX64芯片

- 用于选择输出监测探测器的电压及温度信号
- 与美国SMU大学等单位合作自主研发
  - 老化实验: 35片芯片85℃高温老化16天, 全部通过
  - 高低温循环实验: 16片芯片-40-80℃100次高低温循环, 全部通过
  - 质子辐照实验:累计等效中子计量3.21×10<sup>15</sup> n/cm<sup>2</sup>,电阻变化小于25Ω,通过
  - TID辐照实验: 0.75MGy, 电阻变化小于50Ω, 通过







Mux64芯片



#### 质子辐照实验电阻变化率



#### PEB设计:系统运行脚本开发

- 前端模块、lpGBT、VTRX+均需正确配置后方可运行,需配置上千个寄存器
  - 运行中需要实时控制系统
- 脚本可实现: 硬件初始化、运行参数配置、数据获取、S-曲线及噪声扫描等



系统运行脚本架构, Gitlab: <u>atlas-hgtd / hgtd-PEB · GitLab (cern.ch)</u>

#### PEB设计及验证:系统级测试验证

- 完成系统配置及数据采集测试,控制信号,监测信号及数据收发功能通过验证
- 开展了前端模块关键参数扫描测试

前端模块S-曲线扫描 及噪声扫描





#### PEB 1F 设计

- 最复杂的PEB板: PCB面积小、厚度薄, 元器件及走线密度大
  - 包含9个 timing lpGBT、3个lumi lpGBT、9个VTRX+, 可连接54个前端模块
- 已完成原理图设计及约85% PCB板绘制







总结与展望

#### □ PEB关键器件已完成设计验证,满足设计要求

- □ PEB 1F 样板设计完成约85%, 完成生产后参与探测器演示系统
- □ 后续将重点开展PEB 1F 板测试及演示系统的测试
  - PEB 1F 板测试: 多路控制及配置脚本开发、DAQ测试、可靠性实验、全负载实验等
  - 演示系统: 54个前端模块+柔性连接PCB + PEB 1F + 低压系统 + 高压系统
- □ 预计2024年5月完成所有PEB设计、6月开始提前批生产。

# 谢谢!